

平成 29 年 7 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山村 章
(JASDAQ・コード6890)
問合せ先 取締役経営企画担当 若木 啓男
(03-3281-8186)

中国（寧夏省銀川市）における 8 インチ半導体ウエーハ新工場竣工に関するお知らせ

当社は、昨年 12 月に当社子会社の上海申和熱磁電子有限公司の 100%連結子会社として、8 インチ半導体単結晶インゴット製造工場の新規開設を目的に、中華人民共和国寧夏省銀川市に新会社（寧夏銀和半導体科技有限公司）を設立し、開設準備を進めまいりましたが、このたび新工場が竣工致しましたのでお知らせいたします。

1. 新工場を開設した狙い

当社は 2002 年に中国上海において、6 インチ以下の小口径シリコンウエーハ加工事業に参入して以来、日本、中国、台湾、韓国、欧州などの市場に対し、製品を供給し、順調に事業を拡大して参りました。また、最近『中国製造 2025[®]』に伴う中国政府による中国国内の半導体メーカー育成・強化の中で、8 インチ・12 インチ向け大口径ウエーハの中国国内での調達に対する需要が急速に拡大しております。そのような中で、当社は、先に公表しました通り、世界第 3 位の大手半導体ウエーハ製造・販売会社である台湾の GlobalWafers Corporation 社との間で、業務提携に係る基本覚書を締結し、今日に至るまで同社の協力の下、中国国内における半導体ウエーハの生産体制、販売体制の構築を進めてまいりました。

当社としては、ウエーハ製造におけるコスト競争力確保の戦略的観点から、単結晶インゴットの製造とスライスについては、銀川（寧夏銀和半導体科技有限公司）で行なうことが最良と判断し、昨年より銀川市政府の支援の下、新工場建設を進め、この度 7 月 6 日に竣工致しました。尚、スライス加工後の工程（ポリッシュドウエーハ加工等）につきましては、上海（上海申和熱磁電子有限公司）に増設した専用ラインにて行なうこととなります。今後のスケジュールとしましては、当初計画通り、本第 2 四半期より稼働を開始し、順次、デバイスメーカーの認定取得を進めながら、年内に月産 15 万枚の生産体制に移行していく予定です。

また、次の段階では、さらに月産 30 万枚の生産体制を整え、将来的には月産 45 万枚の生産体制の構築を目指して参ります。

注) 中国政府（國務院）が、「製造強国」を目指すべく、2015 年 5 月 19 日に発表した将来における製造業発展のロードマップであり、2025 年に向けて中国の製造力を世界トップ水準に引き上げる発展方針が打ち出されております。その中には、製造業のイノベーション能力の向上や情報化と工業化の高度な融合の推進をはじめとする九つの戦略任務と、次世代情報技術、高度なデジタル制御の工作機械とロボット、航空・宇宙設備などからなる十の重点分野が盛り込まれており、半導体については、先端 IC とコア製造装置の国産化が主な方針として打ち出されています。

2. 運営会社の概要

(1) 名 称	寧夏銀和半導体科技有限公司	
(2) 所 在 地	中国銀川經濟技術開發区光明西路 28 号	
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4) 事 業 内 容	8 インチ半導体単結晶インゴットの製造を主要業務とする	
(5) 資 本 金	1 億人民元	
(6) 設 立 年 月 日	2015 年 12 月 14 日	
(7) 大株主及び持ち株比率	上海申和熱磁電子有限公司（当社連結子会社）100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社が100%出資している上海申和熱磁電子有限公司が100%出資の孫会社となります。
	人 的 関 係	該当事項はありません
	取 引 関 係	記載すべき取引関係はありません。

3. 工場の概要

(1) 所 在 地	中国銀川經濟技術開發区内
(2) 工 場 契 約 面 積	約 53,333 m ²
(3) 優 遇 措 置	工場建物の建設に関する市政府の優遇措置有り
(4) 投 資 形 態	土地、建物は賃貸。設備、造作物は自己投資による。
(5) 生 産 品 目	8 インチ半導体単結晶インゴット
(6) 投 資 金 額	約 1 億元（工場建物改造費用、設備投資、運転資金を含む）
(7) 稼働開始日	2017 年 7 月 6 日

4. 今後の見通し

当社の平成 30 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上

【新工場の外観】



【竣工セレモニーの様子】

